

삼성전기, 반도체용 기판 1위 도전

부산에 플립칩 2라인 신규건설 ... 2008년 기판부문 세계 1위 기대

삼성전기가 반도체용 기판(플립칩기판) 전용라인을 건설하는 등 세계 1위 반도체용 기판 생산기업으로 등극하기 위해 주력하고 나섰다.

삼성전기는 휴대폰 기판 부문에 이어 반도체용 기판 부문에서도 2008년 세계 1위에 등극할 것이라고 7월13일 발표했다.

삼성전기 관계자는 “플립칩기판은 금속선의 와이어본딩 대신 조그마한 돌기 모양의 범프로 반도체와 연결하도록 제작된 기판으로, 기판을 사용하면 열과 전기 소모가 적고 신호처리 속도가 빨라져 주로 CPU와 칩셋 등 고성능 반도체를 패키징하는데 사용된다”고 설명했다.

삼성전기는 이를 위해 2008년까지 총 3805억원을 투자해 부산사업장에 플립칩 2라인을 신규 건설해 2007년 하반기 생산에 들어가기로 했다.

5000여평 부지에 연건평 1만5000여평에 건립되는 플립칩 2라인은 월 1300만~1500만개 생산규모로, 삼성전기는 기존의 부산, 대전사업장을 포함해 총 2400만~2600만개 수준의 월 생산능력을 갖추게 된다.

삼성전기는 “삼성전기의 단일제품 및 국내 기판업체 사상 최대의 투자금액”이라며 “일본, 타이완 등 경쟁기업들과 동등한 생산능력을 갖추게 돼 2008년 기판부문 세계 1위 등극이 가시화될 것”이라고 기대했다.

삼성전기 기판사업부장 송광욱 전무는 “2003년부터 시작한 플립칩기판 사업이 물량 증가와 품질 개선으로 2005년부터 안정적인 수익성을 확보하고 있다”며 “사업 초기 전체 기판의 3%였던 매출 비중도 2006년 17%까지 확대되는 등 새로운 캐시카우로 발돋움할 것”이라고 강조했다.

삼성전기는 2004년 발표한 비전을 통해 소재, 무선고주파, 광기술 등 3대 전략기술을 중심으로 기판, 카메라 모듈, MLCC를 1위 육성품목으로 선정해 투자의 60% 이상을 집중하고 있다.

한편, 시장조사기관인 프리스마크에 따르면, 2006년 7억9500만개인 플립칩기판 시장은 2010년 16억4000만개로 연평균 22%의 가파른 성장세가 지속될 전망이다. (서울=연합뉴스) <저작권재(c)연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/07/14>